į

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2003年12月25日

出 願 番 号

特願2003-431013

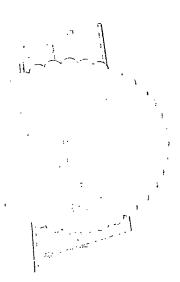
Application Number: [ST. 10/C]:

[JP2003-431013]

REC'D 0 4 NOV 2004
WIPO PCT

出 願 人
Applicant(s):

シャープ株式会社



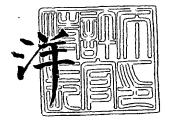
PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 9月17日

(1

[1]



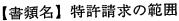
特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office

特許願 【書類名】 03103932 【整理番号】 平成15年12月25日 【提出日】 特許庁長官 殿 【あて先】 G02F 1/1339 【国際特許分類】 【発明者】 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内 【住所又は居所】 臼倉 奈留 【氏名】 【特許出願人】 000005049 【識別番号】 シャープ株式会社 【氏名又は名称】 【代理人】 100077931 【識別番号】 【弁理士】 【氏名又は名称】 前田 弘 【選任した代理人】 100094134 【識別番号】 【弁理士】 小山 廣毅 【氏名又は名称】 【選任した代理人】 100113262 【識別番号】 【弁理士】 竹内 祐二 【氏名又は名称】 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 014409 21,000円 【納付金額】 【提出物件の目録】 特許請求の範囲 1 【物件名】 明細書 1 【物件名】 図面 1 【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0208453

【物件名】



【請求項1】

基板と、前記基板上に形成されたスペーサとを有するスペーサ付き基板であって、 前記スペーサは、第1スペーサ部と、前記第1スペーサ部の上部に形成された第2スペ ーサ部とを少なくとも有しており、前記第1スペーサ部の上部の直径が前記第2スペーサ 部の底部の直径よりも長いスペーサ付き基板。

【請求項2】

前記第1スペーサ部の上部は、平面視において前記第2スペーサ部を囲む溝を有する請 求項1に記載のスペーサ付き基板。

【請求項3】

前記スペーサの上部の直径をCとし、前記スペーサの底部から上部までの高さをHとす ると、前記スペーサの底部の直径が1.8×C以上であり、前記スペーサの底部から0. 85×Hの高さにおける前記スペーサの直径が1.05×C以下である請求項1または2 に記載のスペーサ付き基板。

【請求項4】

請求項1から3のいずれか1項に記載のスペーサ付き基板と、前記スペーサ付き基板に 対向して配置された対向基板と、前記スペーサ付き基板および前記対向基板の間に介在す る機能材料層とを有するパネル。

【請求項5】

前記機能材料層が液晶層である請求項4に記載のパネル。

【請求項6】

請求項5に記載のパネルを製造する方法であって、

前記スペーサ付き基板または前記対向基板のいずれか一方の基板面に枠状シール材を形 成する工程と、

前記シール材の枠内に液晶材料を滴下する工程と、

前記スペーサ付き基板と前記対向基板とを貼り合わせて、前記液晶層を形成する工程と を有する方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】スペーサ付き基板

【技術分野】

[0001]

本発明は基板上にスペーサが形成されたスペーサ付き基板に関する。本発明のスペーサ付き基板と対向基板とを貼り合わせることにより、両基板の間隙を一定に保持することができる。

【背景技術】

[0002]

従来の液晶パネルでは、TFT (Thin Film Transistor) 基板とカラーフィルタ基板との間の液晶層の厚さを一定にするために、両基板を貼り合わせる前に、一方の基板にプラスチックビーズ等の球状のスペーサを散布していた。しかしこの方式では、ビーズの散布ムラやビーズの移動などによって、表示ムラが発生するという問題があった。

[0003]

この問題を解決するために、柱状構造スペーサを基板上に形成する技術が開発されている。柱状構造スペーサは、基板上に感光性樹脂を塗布し、フォトリソグラフィ法により感光性樹脂をパターニングして形成される。柱状構造スペーサは、基板面内の所望の位置に形成することができ、基板面内を移動することもないので、表示ムラが生じることがない。しかも製造条件によってその高さを自由に設定することができる。しかし高温状態では液晶材料が熱膨張するので、柱状構造スペーサを用いた場合、セルギャップの面内不均一による表示ムラが生じてしまう。

[0004]

特許文献1には、柱状の樹脂スペーサに弾性エネルギを蓄えさせることにより、温度変化に対しても表示ムラを生じさせないことが開示されている。特許文献2および3には、低温環境下で液晶材料が収縮した時や過剰な荷重を受けた時でも表示ムラを発生させないように、高さや断面積の異なる2種類以上のスペーサを用いることが開示されている。特許文献4には、柱状スペーサの頂上部分を凹部または平坦に形成することにより、局所的なセル厚ムラによる表示不良を防止することが開示されている。

[0005]

しかしながら、特許文献1~4に記載のスペーサはアスペクト比が高いので、配向膜に ラビング処理を行う工程で、弾性変形しやすいスペーサがダメージを受けて、その機能を 果たさなくなる可能性がある。

[0006]

一方、基板面に液晶材料を滴下した後に貼り合わせる方式(以下、液晶滴下貼り合わせ方式とも呼ぶ)では、液晶材料の滴下量によって液晶層の厚さ(セルギャップ)が決まる。そのため、樹脂スペーサの高さと液晶滴下量のバランスが崩れると、表示に不具合が発生する。具体的には、液晶滴下量が多ければ液晶がだぶつくことによる表示ムラが発生し、少なければ真空気泡が発生して大きな欠点となってしまう。この真空気泡は、とりわけ基板貼り合わせ時や低温時に発生し易く、課題解決が急がれていた。

[0007]

この課題を解決するために、特許文献5には、柱状スペーサの支柱高さを測定し、測定値に基づいて液晶滴下量を制御することが開示されている。しかし測定誤差、滴下量制御の精度および温度変化を考慮すると、特許文献5の方法は十分ではない。

【特許文献1】特開2001-147437 号公報

【特許文献 2】特開2003-121857 号公報

【特許文献 3 】特開2003-131238 号公報

【特許文献 4 】特開2002-229040 号公報

【特許文献 5 】特開2001-281678 号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0008]

本発明の目的の一つは、セルギャップの面内不均一による表示ムラを軽減することである。本発明の他の目的は、スペーサがラビング処理によるダメージを受け難くすることである。本発明のさらなる他の目的は、温度変化や液晶滴下量の過不足などによる表示ムラを低減することである。

【課題を解決するための手段】

[0009]

本発明のスペーサ付基板は、基板と、前記基板上に形成されたスペーサとを有するスペーサ付き基板であって、前記スペーサは、第1スペーサ部と、前記第1スペーサ部の上部に形成された第2スペーサ部とを少なくとも有しており、前記第1スペーサ部の上部の直径が前記第2スペーサ部の底部の直径よりも長い。

[0010]

前記第1スペーサ部の上部は、平面視において前記第2スペーサ部を囲む溝を有することが好ましい。

[0011]

また、前記スペーサの上部の直径をCとし、前記スペーサの底部から上部までの高さをHとすると、前記スペーサの底部の直径が1.8 \times C以上であり、前記スペーサの底部から0.8 $5\times$ Hの高さにおける前記スペーサの直径が1.0 $5\times$ C以下であることが好ましい。

[0012]

本発明のパネルは、本発明のスペーサ付き基板と、前記スペーサ付き基板に対向して配置された対向基板と、前記スペーサ付き基板および前記対向基板の間に介在する機能材料層とを有する。前記機能材料層は、互いに対向する電極間の電位差により光透過率が変調される層、互いに対向する電極間を流れる電流により自発光する層を含む。例えば液晶層、無機または有機エレクトロルミネッセンス(EL)層、発光ガス層、エレクトロクロミック層などである。したがって、本発明のパネルは、液晶パネルや無機または有機ELパネルを含む。

[0013]

本発明の方法は、液晶滴下貼り合わせ方式による液晶パネルの製造方法である。本発明の方法は、前記スペーサ付き基板または前記対向基板のいずれか一方の基板面に枠状シール材を形成する工程と、前記シール材の枠内に液晶材料を滴下する工程と、前記スペーサ付き基板と前記対向基板とを貼り合わせて、前記液晶層を形成する工程とを有する。

【発明の効果】

[0014]

本発明のある局面によれば、面内において均一なセルギャップが得られる。本発明の他の局面によれば、スペーサがラビング処理によるダメージを受け難くすることができる。本発明のさらなる他の局面によれば、温度変化や液晶滴下量の過不足などによる表示ムラを低減することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0015]

以下、図面を参照しながら本発明の実施形態を説明する。以下の実施形態では、液晶パネルに用いられるスペーサ付き基板について説明するが、本発明のスペーサ付き基板は、液晶パネルだけでなく、無機または有機ELパネル、プラズマパネル、フィールドエミッションパネル、エレクトロクロミックパネルなどにも用いることができる。また、液晶パネルは、液晶表示パネルだけでなく、画素を光学的に順次シフトさせる画像シフトパネルや三次元映像を表示可能とするパララックスバリアパネルに適用することもできる。なお、画像シフトパネルは、光の偏光状態を変調する液晶パネルと、この液晶パネルから出射された光の偏光状態に応じて光路をシフトさせる複屈折素子との組合せを少なくとも一組有する。またパララックスバリアパネルは、左目用画素および右目用画素を有する映像表示素子と組み合わせることにより、立体映像を表示することができる。

[0016]

(実施形態1)

図1は実施形態1のスペーサ付き基板を用いた液晶パネルを模式的に示す断面図である。液晶パネルは、一対の基板1,2と、両基板1,2に挟まれた周辺シール材3と、両基板1,2に挟まれ、周辺シール材3に囲まれた液晶層4と、液晶層4のセルギャップを均一にするためのスペーサ5とを有する。一方の基板1はカラーフィルタ基板であり、カラーフィルタ層(不図示)と、ITO(インジウム錫酸化物)などからなる透明電極(不図示)と、ポリイミドなどからなり、ラビング処理された液晶配向膜(不図示)とを有する。他方の基板2はTFT(Thin Film Transistor)基板であり、それぞれが行方向に延びる複数のゲートバスライン(不図示)と、ゲートバスラインと交差して延びる複数のソースバスライン(不図示)と、ゲートバスラインおよびソースバスラインの交差部近傍に設けられたTFT(不図示)と、ケートバスラインおよびソースバスライン(不図示)に接続され、マトリクス状に配置された画素透明電極(不図示)と、画素透明電極を覆う液晶配向膜(不図示)とを有する。

[0017]

基板1,2の材料としては、石英ガラスやソーダライムガラス、ホウケイ酸ガラス、低アルカリガラス、無アルカリガラスなどのガラス、ポリエステルやポリイミドなとのプラスチック、シリコンなどの半導体が挙げられる。

[0018]

図2は本実施形態のスペーサ5を模式的に示す拡大断面図であり、図3はスペーサ5の 平面図である。本実施形態では、カラーフィルタ基板1上にスペーサ5が形成されている 場合について説明するが、TFT基板2上にスペーサ5が形成されていても良い。

[0019]

スペーサ5は、第1スペーサ部5 aと、第1スペーサ部5 aの上部に形成された第2スペーサ部5 bとを有する。第1スペーサ部5 aおよび第2スペーサ部5 bは、それぞれ錐台の形状を有しており、第1スペーサ部5 aの上部の直径Aが第2スペーサ部5 bの底部の直径Bよりも長い。

[0020]

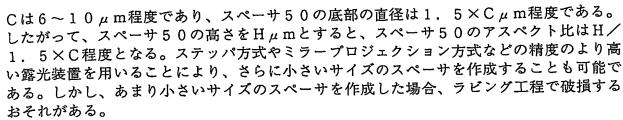
図2および図3に示すように、スペーサ5は上底面積(上面の面積)が相対的に大きい第1スペーサ部5aと、上底面積が相対的に小さい第2スペーサ部5bとを組み合わせた形状をしている。このように組み合わせた形状を採用することで、基板1の面から高い位置に上底面積が相対的に小さい部分(第2スペーサ部5b)があっても、ラビング工程の際にダメージを受けにくくなる。

[0021]

また、上底面積(上面の面積)が相対的に大きい第1スペーサ部5a上に上底面積が相対的に小さい第2スペーサ部5bを形成することにより、スペーサの荷重一変位特性を段階的に変化させることができる。図4は本実施形態のスペーサ5の荷重一変位特性を示すグラフである。図4に示すように、荷重一変位特性のグラフは、第2スペーサ部5bの高さh2を超えるまでは傾きが急な非線型を描いているが、第2スペーサ部5bの高さh2を超えて荷重を続けると、荷重一変位特性が極端に変わり、傾きが緩やかな非線型を描く。すなわち、第2スペーサ部5bの高さh2を超えて荷重を続けると、変位し難くなる。これにより、液晶滴下量の誤差および温度変化による荷重に対して、第2スペーサ部5bが弾性変形することにより追従することができる。一方、局所的な強い圧力に対しては、第1スペーサ部5aの応力によりパネルが比較的変形し難くなる。

[0022]

次に、本実施形態の対比説明をするために、比較例について記載する。図5は比較例のスペーサ50を模式的に示す断面図である。スペーサ50は、図5に示すように、1つの錐台の形状を有する。一般に、スペーサはフォトリングラフィ法を用いて形成されるので、スペーサ50の上部の直径Cは、露光装置の精度などにより制約される。一般的に使用されているプロキシミティ方式の露光装置を用いた場合には、スペーサ50の上部の直径



[0023]

図6は本実施形態のスペーサ5の大きさを説明するための断面図である。本実施形態のスペーサ5は、それぞれが錐台の形状を有する第1スペーサ部5aと第2スペーサ部5bとを上下に組み合わせた構造であり、第1スペーサ部5aの上部の直径Aが第2スペーサ部5bの底部の直径Bよりも長いので、比較例のスペーサ50に比してスペーサ5の底部の直径Dを長くすることができる。例えば、スペーサ5の底部の直径Dを1.8×C以上とすることができる。したがって、スペーサ5のアスペクト比をH/1.8×C以下、すなわち比較例のスペーサ50よりもアスペクト比を小さくできるので、小さいサイズのスペーサを作成した場合でも、ラビング工程での破損を防ぐことができる。

[0024]

スペーサ 5 の典型的な大きさについて説明する。プロキシミティ方式の露光装置を使用することがコスト的に有利であるので、プロキシミティ方式の露光装置を用いた場合について説明する。プロキシミティ方式の露光装置による精度は 6 μ m程度が限界であるので、第 2 スペーサ部 5 b の上部の直径 C は最低 6 μ m程度となる。一方、スペーサ 5 の底部(本実施形態では第 1 スペーサ部 5 a の底部)の直径 D は、第 2 スペーサ部 5 b の上部の直径 C の 1.8 倍以上に設定する。ただし、スペーサ 5 の底部の直径 D をあまり大きくすると、画素開口部にスペーサ 5 がかかってしまい、透過率や反射率を低下させるなどの表示への悪影響が生じる。そこで、画素開口部にかからないように、スペーサ 5 の底部の直径 D は 1 4 μ m程度とする。第 2 スペーサ部 5 b の上部の直径 C を 6 μ m とした場合におけるセル内のスペーサ密度は 1 0 0 0 個 μ c m 2 程度が好ましい。

[0025]

スペーサ 5 の高さHは、液晶層 4 のセルギャップに概ね等しい。具体的には、透過表示型であれば 5 μ m程度であり、反射表示型であれば 2.5 μ m程度である。ただし、基板 1,2 を重ね合わせたときにスペーサ 5 が若干つぶれるので、その分の見込量(0.2 μ m程度)をセルギャップに加えた値がスペーサ 5 の高さHとなる。例えば、透過表示型であれば 5.2 μ m程度であり、反射表示型であれば 2.7 μ m程度である。

[0026]

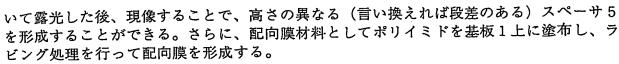
第2スペーサ部5bは、液晶滴下量の誤差や温度変化による荷重に追従して弾性変形する。第2スペーサ部5bの高さh2は、局所的な強い圧力に対しても所定の厚み以上にスペーサ5がつぶれないように設定する。また液晶滴下量やスペーサ5の高さのばらつき、液晶材料の膨張によるセルギャップの面内ずれなどを考慮して、高さh2を設定する。第2スペーサ部5bの高さh2は、好ましくは0.4 μ m以上0.7 μ m以下であり、典型的には0.5 μ mである。

[0027]

本実施形態のスペーサ 5 は、スペーサ 5 の底部から上部までの高さをHとすると、スペーサ 5 の底部から 0. 8 $5 \times H$ の高さにおけるスペーサ 5 の直径 E がスペーサ 5 の上部の直径 E の 1. 0 5 倍以下、すなわち 1. 0 $5 \times E$ 以下である。

[0028]

次に、本実施形態のスペーサ付き基板を用いて液晶表示パネルを製造する工程について 説明する。まず、一方の基板 1 上に、スパッタ法や印刷法などにより、カラーフィルタ層 および透明電極を順次形成する。紫外線硬化型のアクリル樹脂レジストを基板 1 上に塗布 し、乾燥させた後、フォトリソグラフィ法により画素間の遮光位置にスペーサ 5 を形成す る。フォトリソグラフィ法では、一部の透過率が連続的もしくは段階的に変化する遮光部 を有する階調フォトマスクを用いる(例えば特許文献 4 を参照)。階調フォトマスクを用



[0029]

他方の基板 2 上に、フォトリソ法や印刷法などにより、各種のバスラインや絶縁膜、TFT、画素透明電極を形成した後、画素透明電極を覆う、ラビング処理された配向膜を形成する。両基板 1 , 2 のうちいずれか一方の基板の面に、スクリーン印刷方式やディスペンサ方式によって、エポキシ樹脂を含有する U V硬化型の周辺シール材 3 を形成する。周辺シール材 3 のパターンは、液晶注入口となる開口を持たず、閉じたループ状である。周辺シール材 3 のパターン枠内に、例えばネマティック液晶材料を滴下した後、真空チャンバ内で両基板 1 , 2 を重ね合わせて、両基板 1 , 2 の間隙に液晶層 4 を形成する。

[0030]

両基板1,2の間隙、言い換えれば液晶層4の厚み(セルギャップ)は、滴下する液晶材料の量と周辺シール材3の高さによって決まる。しかし、液晶材料と周辺シール材3だけではセルギャップの面内ムラが発生しやすくなる。またパネルの周辺部以外にはセルギャップを規定する部材がないので、パネルが外部圧力による影響を大きく受けて表示ムラが生じる。本実施形態では、セルギャップを規定するスペーサ5が基板1上の表示領域内でほぼ均一になるように配置されているので、パネルが外部圧力による影響を受け難く、したがって表示ムラが生じ難い。

[0031]

また本実施形態では、第1スペーサ部5a上の第2スペーサ部5bにより、液晶滴下量の誤差や温度変化による荷重が吸収されるので、セルギャップの面内不均一による表示ムラを軽減することができる。さらに、第1スペーサ部5aの上部の直径Aが第2スペーサ部5bの底部の直径Bよりも長いので、基板の貼り合わせ時などに生じる局所的な強い圧力に対しては、第1スペーサ部5aの応力によりパネルが変形し難くなり、表示品位が保持される。

[0032]

両基板1,2を重ね合わせた後、UV光で周辺シール材3とは異なる部分のシール材(ダミーシール材とも呼ぶ)の一部を仮硬化させる。パネルを真空チャンバ内から取り出し、周辺シール材3にUV光を照射して、周辺シール材3の硬化を行う。以上の工程により、図1に示す液晶パネルが製造される。

[0033]

本実施形態の液晶パネルでは、液晶駆動素子としてTFTが用いられているが、MIM (Metal Insulator Metal) などの他のアクティブ駆動素子を用いても良く、あるいは駆動素子を用いないパッシブ(マルチプレックス)駆動でも良い。なお、液晶パネルを表示パネルとして用いる場合には、透過型、反射型、透過反射両用型のいずれの表示パネルにも適用することができる。

[0034]

本実施形態では、液晶滴下貼り合わせ方式により液晶パネルを製造する場合について説明した。しかし、本発明のスペーサ付き基板を用いて、他の方式により液晶パネルを製造することもできる。

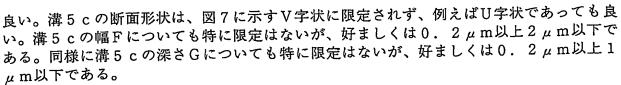
[0035]

(実施形態2)

図7は実施形態2のスペーサ付き基板を模式的に示す断面図であり、図8はその平面図である。本実施形態で示すスペーサ5は、第1スペーサ部5aの上部が溝5cを有することを除いて、実施形態1のスペーサ5と同様である。したがって、本実施形態で示すスペーサ5の形状や大きさ、製造法については、実施形態1の記載をもって説明に代える。

[0036]

第2スペーサ部5bの底部近傍に形成された溝5cは、平面視において第2スペーサ部5bを囲む。本実施形態では、溝5cが連続する輪状であるが、不連続な輪状であっても



[0037]

平面視において溝 5 c が第 2 スペーサ部 5 b を囲むことにより、液晶滴下量の誤差や温 度変化による荷重に対して、第2スペーサ部5bの弾性変形が容易となり、荷重の吸収が より確実なものとなる。

[0038]

(実施形態3,4)

実施形態1および2では、第1スペーサ部5aおよび第2スペーサ部5bがともに錐台 の形状を有しているが、第1スペーサ部5aおよび第2スペーサ部5bの形状はこれに限 定されない。図9(a)および(b)は、それぞれ実施形態3および4のスペーサを模式 的に示す平面図(上図)と断面図(下図)である。

[0039]

図9(a)に示すように、第1スペーサ部5aおよび第2スペーサ部5bがともに円柱 状であり、第2スペーサ部5bが第1スペーサ部5aの上部の略中央に形成されていても 良い。また図9(b)に示すように、第2スペーサ部5bが第1スペーサ部5aの上部の 周縁に形成されていても良い。図9 (a) および (b) それぞれに示すスペーサ 5 も、実 施形態1および2に示したスペーサ5と同様の効果が期待できる。

[0040]

(他の実施形態)

第1スペーサ部5aおよび第2スペーサ部5bは、実施形態1および2では錐台形状で あり、実施形態3では円柱状である。言い換えれば、スペーサ部5 a, 5 bは、実施形態 $1 \sim 3$ では、上部および底部の各面が円形である。しかしスペーサ部 5 a , 5 b の上部お よび底部における各面の形状は特に限定されず、例えば多角形、楕円などでも良い。また スペーサ部5a,5bの各上部の面は、基板面に平行でなくても良く、基板面に対して傾 斜していても良い。基板面に平行な面を用いて、スペーサ部5a, 5bの上部または底部 を切断したときの切断面が円形でない場合には、直線がその切断面を横切ったときにでき る線分のうち最も長いものを「直径」と呼ぶ。

[0041]

実施形態1~4では、スペーサ5が2つのスペーサ部5a, 5bから構成される場合に ついて説明したが、スペーサがさらなるスペーサ部を有する多段状であっても良い。

【産業上の利用可能性】

[0042]

本発明のスペーサ付き基板は、液晶パネル、無機または有機ELパネル、プラズマパネ ル、フィールドエミッションパネル、エレクトロクロミックパネルなどに用いることがで きる。

【図面の簡単な説明】

[0043]

- 【図1】実施形態1のスペーサ付き基板を用いた液晶パネルを模式的に示す断面図で ある。
- 【図2】実施形態1のスペーサ5を模式的に示す拡大断面図である。
- 【図3】実施形態1のスペーサ5の平面図である。
- 【図4】実施形態1のスペーサ5の荷重-変位特性を示すグラフである。
- 【図5】比較例のスペーサ50を模式的に示す断面図である。
- 【図6】実施形態1のスペーサ5の大きさを説明するための断面図である。
- 【図7】実施形態2のスペーサ付き基板を模式的に示す断面図である。
- 【図8】実施形態2のスペーサ付き基板の平面図である。
- 【図9】図9(a)および(b)は、それぞれ実施形態3および4のスペーサを模式

(‡.

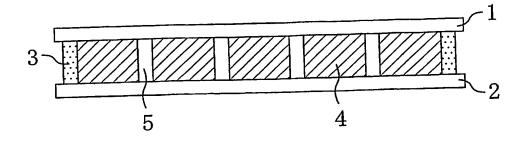
的に示す平面図(上図)と断面図(下図)である。

【符号の説明】

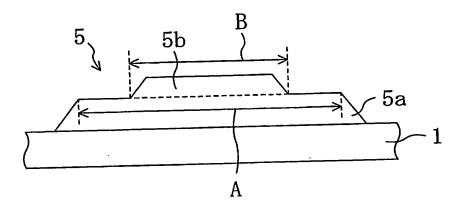
[0044]

- 1, 2 基板
- 3 周辺シール材
- 4 液晶層
- 5 スペーサ
- 5 a 第1スペーサ部
- 5 b 第2スペーサ部
- 5 c 溝
- 50 スペーサ

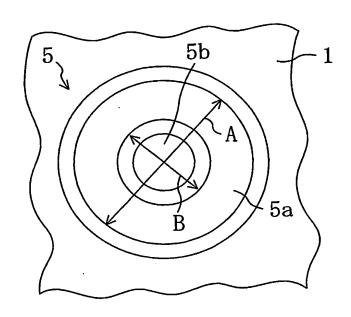
【書類名】図面 【図1】



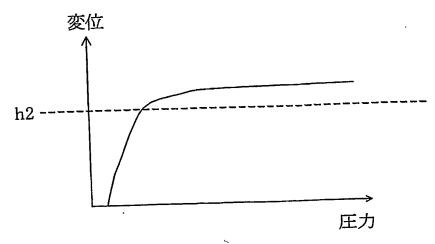
【図2】



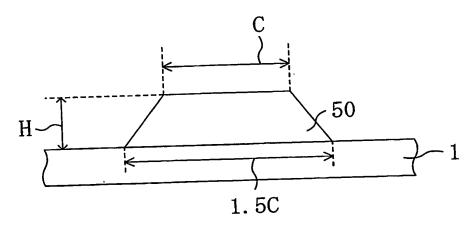
【図3】



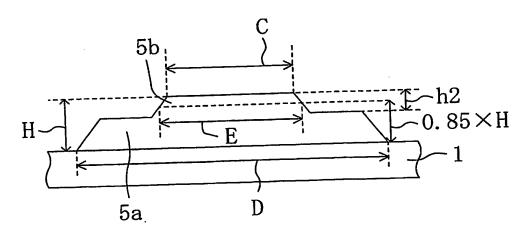
【図4】



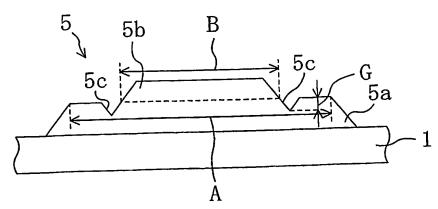
【図5】



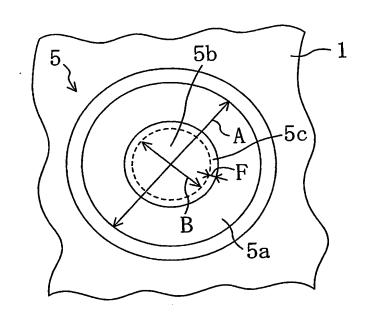
【図6】



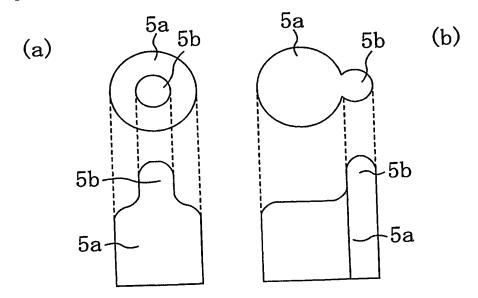
【図7】

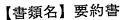


【図8】



【図9】





【要約】 セルギャップの面内不均一による表示ムラを軽減する。スペーサがラビング処 理によるダメージを受け難くする。温度変化や液晶滴下量の過不足などによる表示ムラを 【課題】 低減する。

スペーサ付き基板は、基板1と、基板1上に形成されたスペーサ5とを有 する。スペーサ5は、第1スペーサ部5aと、第1スペーサ部5aの上部に形成された第 【解決手段】 2スペーサ部 5 b とを少なくとも有する。第1スペーサ部 5 a の上部の直径 A が第 2 スペ ーサ部5bの底部の直径Bよりも長い。

【選択図】 図2

特願2003-431013

出願人履歴情報

識別番号

[000005049]

1. 変更年月日

1990年 8月29日

[変更理由]

新規登録

住 所 氏 名 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

シャープ株式会社